

## **D a t e n b l a t t**

### **Holzspan – Bohrunterlage HDF 25 (PWU)**

HDF 25 ist ein Qualitätsprodukt, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse und die besonderen Anforderungen, bei der Verarbeitung im Bereich Leiterplattenfertigung.

Diese Holzspan-Bohrunterlage eignet sich besonders zum Einsatz beim Bohren und Fräsen von ein- und doppelseitigen Leiterplatten sowie bei Standard-Multilayertypen.

Die mit Hochdruck verpresste Bohrunterlage minimiert den Bohrgrat und bietet damit ein hervorragendes Kosten-/Nutzenverhältnis.

#### **Technische Daten**

Dicke: 2,5 +/- 0,2 mm  
Dichte: > 830 kg/m<sup>3</sup>  
Biegefestigkeit: > 50 N/mm<sup>2</sup>  
Oberflächenhärte: > 70 Shore

Die Entsorgung der Holzspan-Bohrunterlagen kann in Deutschland unter Berücksichtigung der Bundes Immissions-Schutz Verordnung thermisch erfolgen.